

**特点**

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
- 采用进口玻璃钝化芯片焊接，优良的温度特性进口和功率循环能力
- 体积小，重量轻

**典型应用**

- 变频器
- 交直流电机控制
- 各种整流电源

I <sub>F(AV)</sub>	600A
V <sub>RRM</sub>	500-2500V
I <sub>FSM</sub>	15 KA
I <sup>2</sup> t	1150 10 <sup>3</sup> a <sup>2</sup> s

符号	参数	测试条件	结温 T <sub>J</sub> (℃)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I <sub>F(AV)</sub>	正向平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 单面散热, T <sub>C</sub> =100°C	150			600	A
I <sub>F(RMS)</sub>	方均根电流		150			924	A
V <sub>RRM</sub>	反向重复峰值电压	V <sub>RRM</sub> tp=10ms V <sub>RSM</sub> =V <sub>RRM</sub> +200V	150	500		2500	V
I <sub>RRM</sub>	反向重复峰值电流	V <sub>RM</sub> =V <sub>RRM</sub>	150			40	mA
I <sub>FSM</sub>	正向不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波 V <sub>R</sub> =0.6V <sub>RRM</sub>	150			15.0	KA
I <sup>2</sup> t	浪涌电流平方时间积					1150	A <sup>2</sup> S*10 <sup>3</sup>
V <sub>FO</sub>	门槛电压		150			0.75	V
r <sub>F</sub>	斜率电阻					0.32	mΩ
V <sub>FM</sub>	正向峰值电压	I <sub>FM</sub> =1800A	25			1.35	V
R <sub>th(j-c)</sub>	热阻抗 (结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				1.70	°C/W
R <sub>th(c-h)</sub>	热阻抗 (壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.011	°C/W
V <sub>iso</sub>	绝缘电压	50Hz,R.M.S,t=1min,I <sub>iso</sub> :1mA(max)		2500			V
F <sub>M</sub>	安装扭矩 (M5)				12		N·m
	安装扭矩 (M6)				6		N·m
T <sub>stq</sub>	储存温度			-40		125	°C
W <sub>t</sub>	质量				1820		g
Outline	外形						

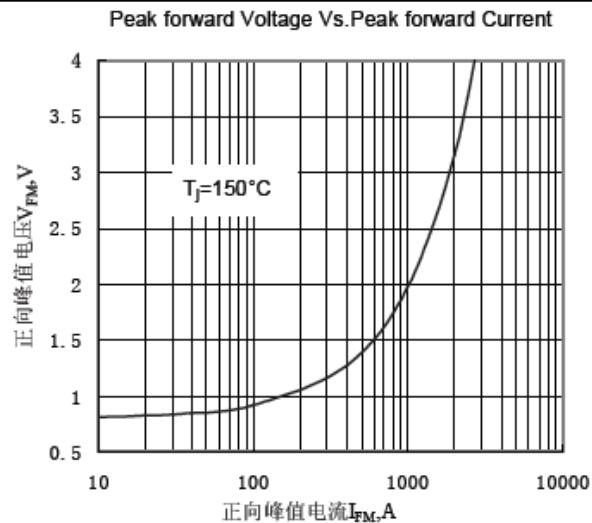


Fig.1 正向伏安特性曲线

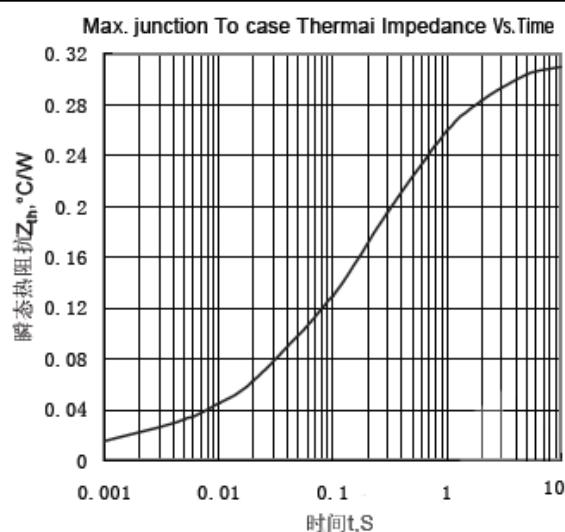


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

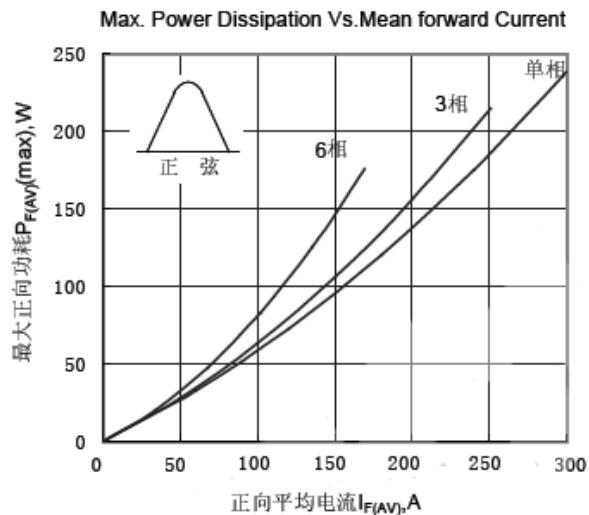


Fig.3 最大正向功耗与平均电流关系曲线

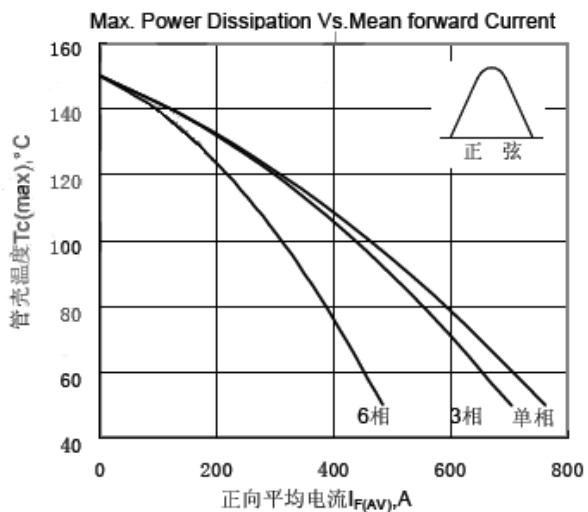


Fig.4 管壳温度与正向平均电流关系曲线

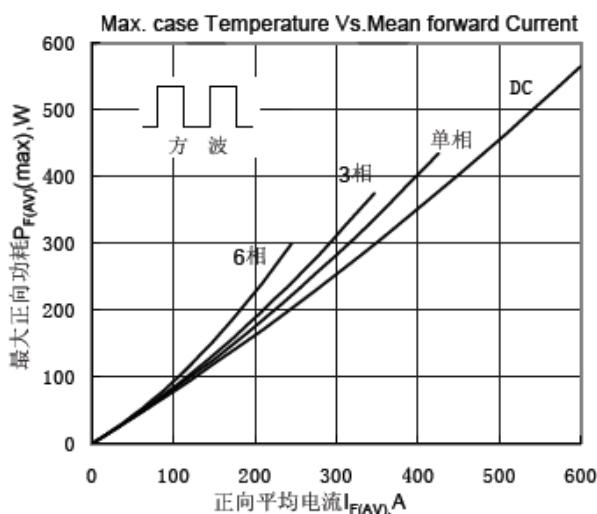


Fig.5 最大正向功耗与平均电流关系曲线

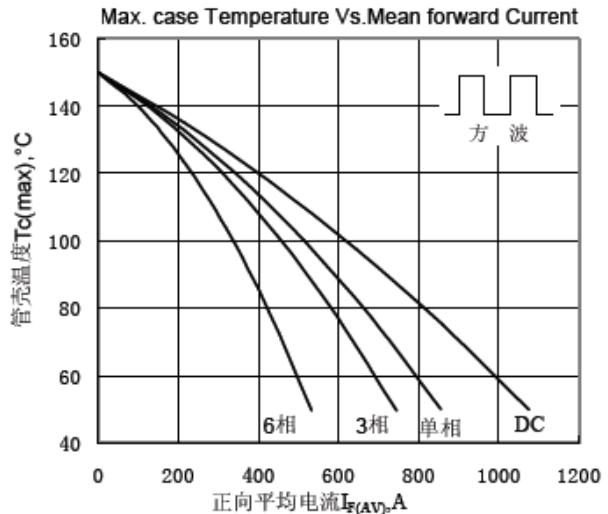


Fig.6 管壳温度与正向平均电流关系曲线

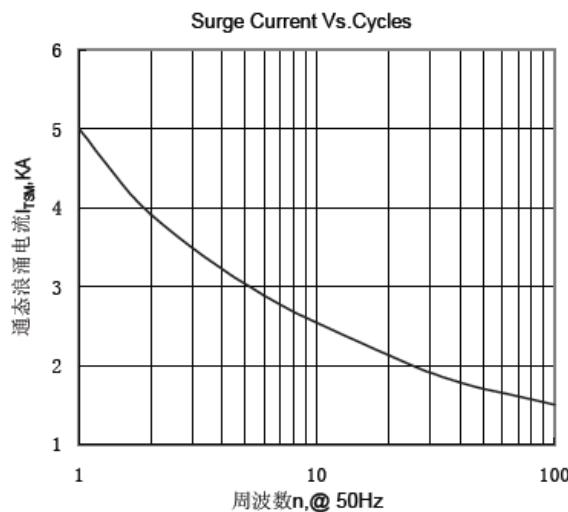


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

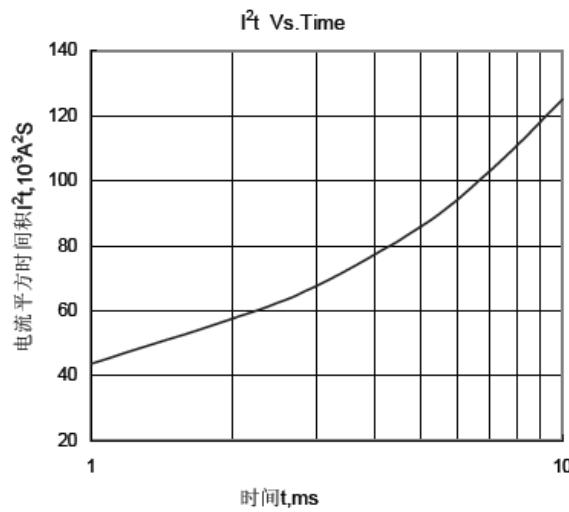


Fig.8 I<sup>2</sup>t 特性曲线

### 外形图：

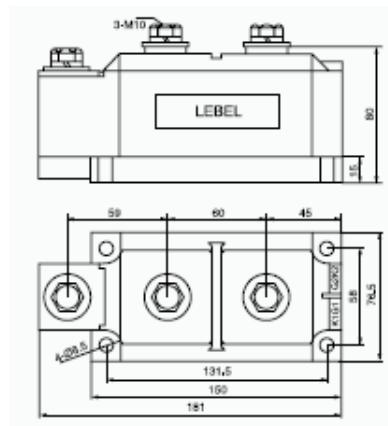


图 1

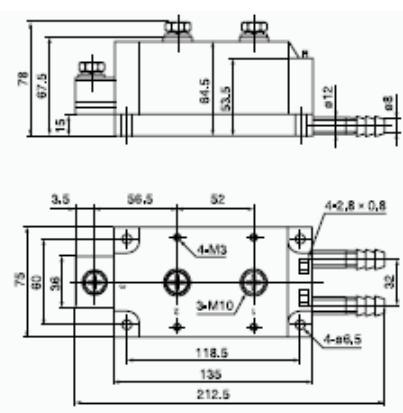


图 2

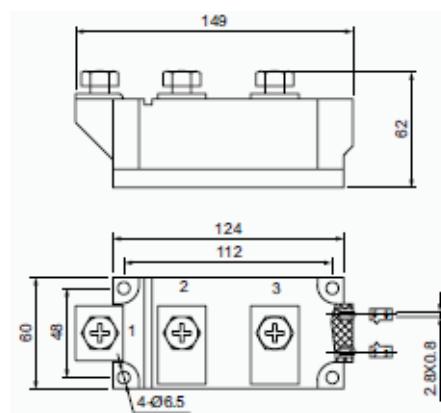


图 3

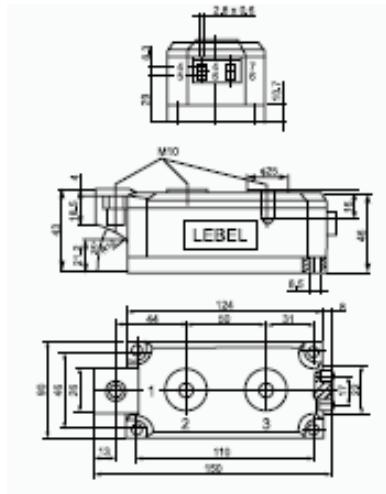


图 4

线路图：

